

Composite-Entlötpitze SOP 13L - Hakko T8-1008

Artikel-Nr. HK-T8-1008

Hersteller Hakko

EAN 4962615010033

Kein Produktbild

Composite-Entlötpitze im Format SOP 13L für den Einsatz mit der Hakko FM 2022 Parallel-Entlötpinzette. Ermöglicht das präzise Entfernen von SMD-Bauteilen. Lieferung als 2er-Pack.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
---------	--------

Ursprungsland	Japan
---------------	-------

Zolltarifnummer	85159080
-----------------	----------

BESCHREIBUNG

ÜBERSICHT

Die Hakko T8-1008 ist eine Composite-Entlötpitze, die speziell für das Parallel-Entlötpinzetten-System FM 2022 entwickelt wurde. Im Format SOP 13L ausgeführt, ermöglicht diese Spitze das effiziente und kontrollierte Entfernen von oberflächenmontierten integrierten Schaltkreisen und anderen SOP-Bauteilen von Leiterplatten, ohne die umliegenden Schaltungen zu beschädigen.

WESENTLICHE MERKMALE

- Format SOP 13L, optimiert für Small-Outline-Gehäuse
- Composite-Aufbau für höhere Langlebigkeit und thermische Leistung
- Kompatibel mit der Parallel-Entlötpinzette FM 2022
- Präzisionsgefertigt für ein kontrolliertes Entfernen von Bauteilen
- 2er-Pack für einen verlängerten Einsatz
- Reduziert die thermische Belastung der Leiterplatte beim Entlöten

ANWENDUNGEN

Ideal für Nacharbeits- und Reparaturarbeiten an Small-Outline-Bauteilen, darunter SOP-ICs, Mikrocontroller und andere miniaturisierte SMD-Bauteile. Geeignet für die Elektronikfertigung, die Leiterplattenbestückung und Reparaturen auf Bauteilebene.

LIEFERUMFANG

- 2 × Composite-Entlötpitzen Format SOP 13L